

■ Produktbeschreibung

Die pastösen Flussmittel (Tacky Flux) von ELSOLD sind für vielfältige Einsatzzwecke in der Elektronikfertigung geeignet. Pastöse Flussmittel vereinen die Vorteile von SMD-Klebern und Flussmitteln. Aufgrund der guten Klebekraft werden Komponenten bis zum Löten in Position gehalten. Die Flussmittel sind wirksam bei bereits vorhandenen Lotdepots; zusätzliches Lot kann aber auch, z.B. in Drahtform, zugeführt werden. Die Flussmittel können durch Dispensen, Sieb- oder Schablonendruck aber auch durch Tauchen oder Bestreichen aufgebracht werden. Die Flussmittel zeichnen sich durch hohe Klebekraft, ausgezeichnetes Benetzungsverhalten, weite Prozessfenster und hohe Kompatibilität mit den meisten Leiterplattenoberflächen aus.

Typische Einsatzzwecke sind

- Nacharbeit und Touch-up
- Montieren von BGA's und Lotkugeln
- Löten von Flip Chip Komponenten

Es stehen verschiedene Typen für unterschiedliche Anforderungen und Verwendungen zur Verfügung.

■ Flussmitteltypen

| ELSOLD Pastenflussmittel | Flusmitteltyp | Klasse nach J-STD-004 | Anwendung |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--|
| AP-10 | No clean | ROL1 | Blei- und hochbleihaltige Lote |
| AP-20 | No clean | RELO | Hohe Zuverlässigkeit, besonders geeignet für bleifreie Lote |
| AP-40 | No Clean | RELO | Hohe Zuverlässigkeit, helle Rückstände, gleichermaßen geeignet für bleifreie und bleihaltige Anwendungen |
| NC 559 | No clean | RELO | Besonders helle Rückstände |
| SM-388 | No clean | RELO | Etwas stärker aktiviert, geeignet für bleihaltige und bleifreie Prozesse |
| WS 4200 | Wasserlöslich | REMO | Mit Wasser abwaschbar |

■ Anwendung

Pastenflussmittel eignen sich bestens für Nacharbeiten. Die Flussmittel können direkt aus der Spritze mittels Dispenser sparsam dosiert werden. Im Schablonen- oder Siebdruckverfahren können mehrere sowie großflächige Depots gleichzeitig mit Flussmittel beschickt werden. Für einfache Anwendungen können pastöse Flussmittel manuell aufgetragen werden.

■ Reinigung

Die Reinigung der Werkzeuge kann manuell mit Isopropanol oder in automatischen Reinigungsanlagen für Schablonen und die Reinigung von Fehldrucken erfolgen. Flussmittlrückstände sind mit üblichen kommerziell erhältlichen Reinigungsmitteln zu entfernen.

■ Verpackung

Spritzen: 10 ccm (10 g) und 30 ccm (30 g)
 Kartusche: 6 oz (150 g)
 Dosen: 90 g und 180 g

■ Lagerung und Lagerfähigkeit

Dosen: 12 Monate im ungeöffneten Gebinde unter dauernder Kühlung zwischen 6 und 16°

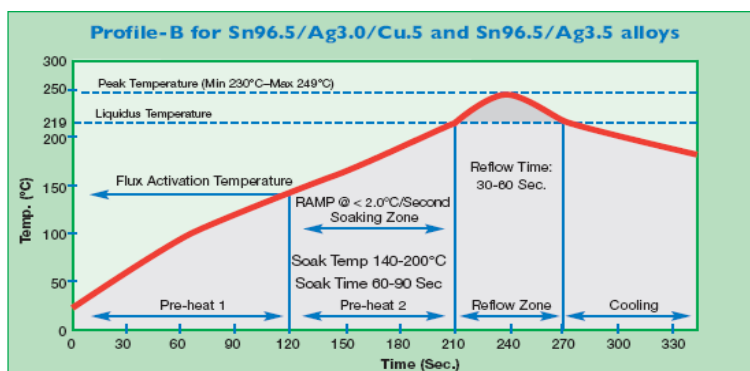
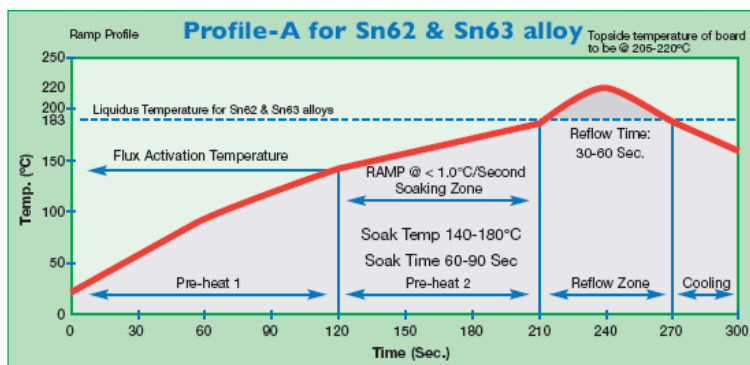
Kartuschen: maximal 12 Monate unter dauernder Kühlung zwischen 6 und 16°C

Spritzen und Kartuschen senkrecht mit der Spitze nach unten lagern, Pastenflussmittel niemals einfrieren.

Vor dem Öffnen der Gebinde soll das Material Raumtemperatur angenommen haben.

■ Reflowprofile

Bei der Anwendung von pastösen Flussmitteln eignen sich die unten angegebenen Lötprofile als Ausgangspunkt für die Optimierung eigener Prozesse.



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.